

セラミックス封止用レーザーガラスフリット

Glass Frit for Laser-sealing of Ceramic Packages



使用例
Application example

レーザーガラスフリットはセラミックスパッケージとガラスリッド(ふた)の気密封止を可能にします。従来よりも熱膨張係数が低く、セラミックスとの濡れ性に優れるレーザーガラスフリットは、高い信頼性が必要とされる気密封止用途で使うことができます。

Glass frit for laser-sealing can create hermetic seals between glass lids and ceramic packages. This glass frit has a lower CTE* than conventional products and excellent wettability with ceramics. Therefore, this glass frit is suitable for hermetic sealing applications requiring high reliability.

*CTE: coefficient of thermal expansion

特長

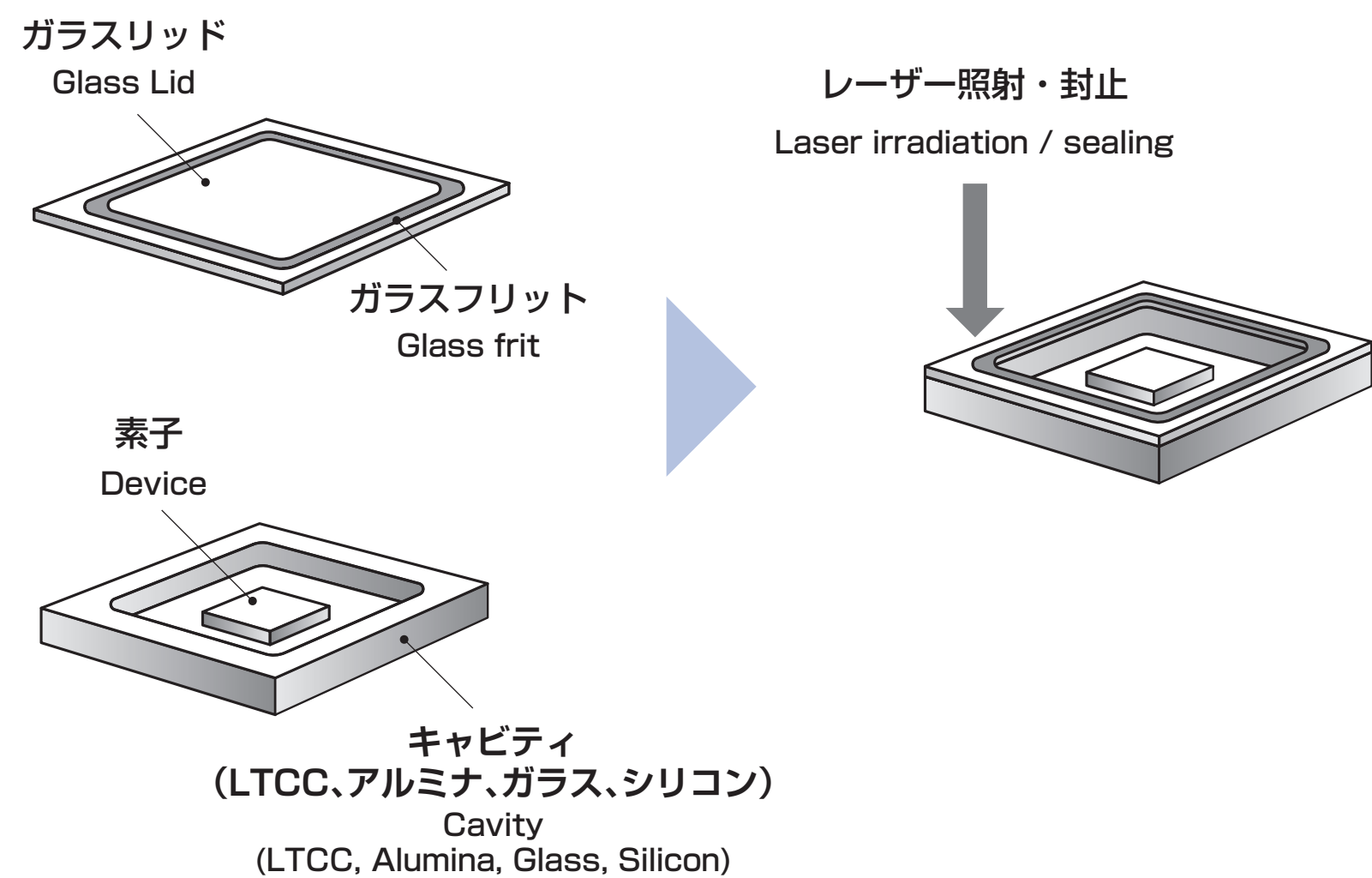
Features

- さまざまなセラミックスパッケージ材に整合した低い熱膨張係数 (CTE 6.5 ~ 7.2ppm/°C)
 - セラミックスとの濡れ性に優れています。
 - 局所加熱封止により内部素子への熱ダメージを防止します。
 - 封止後は高い気密信頼性が得られます。
 - ガラスフリット付きガラスリッドで提供します。
- Similar CTE to ceramic material
CTE: 6.5 to 7.2ppm/°C
 - Excellent wettability with ceramics
 - Prevents thermal damage to internal devices
 - High reliability of hermetic sealing
Glass lid with glass frit is available.

*LTCC: low temperature co-fired ceramics

レーザーシールプロセス

Laser-Sealing process



対応可能なキャビティ材質とサイズ

Available Materials and Sizes

キャビティ材質 Cavity Material	パッケージ・基板サイズ Package/Substrate Size	ガラスリッド厚 Glass Lid thickness
LTCC	~60mm	~1mm
アルミナ Alumina	~60mm	~0.5mm
ガラス Glass	~200mm	~1mm
シリコン Silicon	~10mm	~0.2mm

用途

Applications

- MEMS パッケージ
 - 深紫外LED パッケージ
 - 気密封止パッケージ
 - 有機EL デバイス
- Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) packages
 - Deep UV LED packages
 - Hermetic sealing for packages
 - OLED devices



パネルダウンロードはこちら↓